



联络人

投资人关系

+886 3397 5999 ext. 1204

ir@winfoundry.com

稳懋半导体公告 2014 年第四季财务报告

2015 年 3 月 11 日

稳懋半导体，全球最大砷化镓晶圆代工服务公司，已于今(11)日公告 2014 年第四季财务报告。

2014 年第四季财务概况

- ◆ 本季合并营收新台币 27.13 亿元，较前一年同期增加 41%，较前季减少 12%
- ◆ 本季合并毛利率为 37.3%，较前季增加 0.3 个百分点；
本季营业净利率 24.9%，较前季减少 3.3 个百分点
- ◆ 本季营业净利为新台币 6.77 亿元，较前一年同期增加 177%，较前季减少 22%
- ◆ 本季税后净利为新台币 5.57 亿元，较前一年同期增加 342%，较前季减少 26%；
每股盈余为新台币 0.75 元，前季为新台币 1.02 元
- ◆ 全年合并营收为新台币 99.10 亿元，每股盈余为新台币 2.65 元

2015 年第一季展望

下列对于未来展望的表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。请参阅后附之「免责声明」。

- ◆ 预计 2015 第一季营收可望达到与去年第四季持平的水平。
- ◆ 预计 2015 第一季毛利率可望有接近去年下半年的表现，主要归功于公司持续致力于产品多样化的成效。

管理者评论

“我们很高兴看到2014年第四季有很好的营运表现，虽然第四季营收较第三季季节性衰退了12%，但是优异的年成长及毛利率显现出稳懋不但走出前一波产业的低潮，而且利用稳懋技术多元的优势，成功的优化了产品组合、分散了市场风险，2014年也缔造了优于前一年的获利表现。

我们曾于2012年勾勒过产业趋势的发展及稳懋短、中、长期的成长动能，如今时隔三年，我们很高兴看到当年的看法一一应验，甚至提早到来。如今，我们最新的观察，进一步认为稳懋短期的成长动能应该以4G LTE的成长及Wi-Fi 802.11ac 2GHz及5GHz双频段的导入为主轴；中期则以Wi-Fi 802.11ac在router及MIMO的进展、IoT在无线连结上的应用，以及Infrastructure的需求等为核心；长期则以4G之后，5G的制定与导入为观察重点。

展望未来，我们对于2015年第一季营收可望淡季不淡以及预期的毛利表现感到振奋，并对全年的看法乐观期待，我们会持续善用技术的优势，致力于产品多样化的策略，进一步提升我们的经营绩效。”

关于稳懋半导体

稳懋半导体是领先全球的专业砷化镓晶圆代工服务公司。稳懋拥有超过15年的砷化镓晶圆代工经验，总部位于林口华亚科技园区，现有超过1,500名员工，并通过ISO9001/14001认证。稳懋拥有完整的技术团队，在微波无线宽带通讯领域中，提供全面的制程技术蓝图及制造能力。稳懋产品线可满足50 MHz至100 GHz内各种不同频带无线传输系统的应用，包含智能型手机、行动通讯基础设施、光纤通讯、有线电视(CATV)及车用市场等领域。

免责声明

本数据可能包含对于未来展望的表述。该类表述是基于对现况的预期，但同时受限于已知或未知风险或不确定性的影响。因此实际结果将可能明显不同于表述内容。除法令要求外，公司并无义务因应新信息的产生或未来事件的发生主动更新对未来展望的表述。